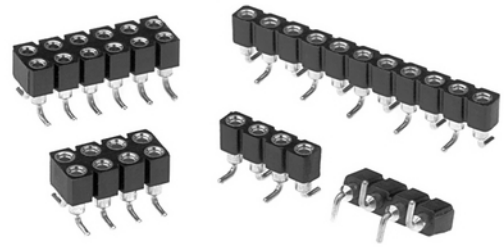


SMT-Präzisions-Buchsenleisten RM 2,54mm, stehend - BH 5,8mm SMT Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Vertical - 5.8mm Profile

Technische Daten / Technical Data

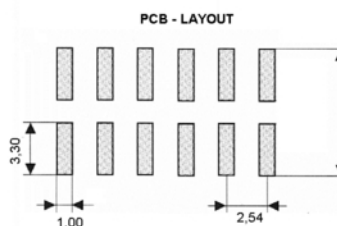
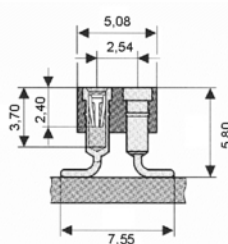
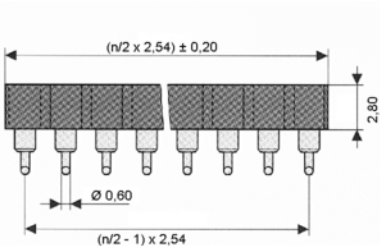
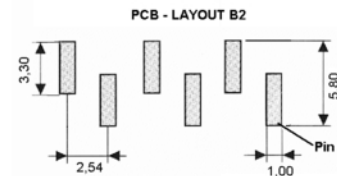
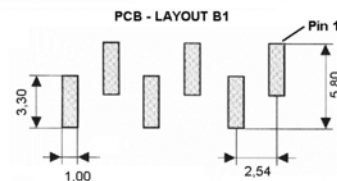
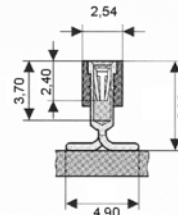
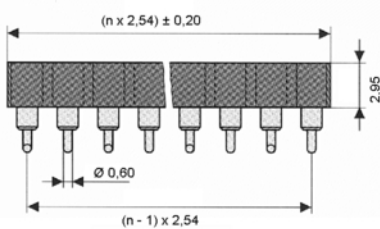
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined brass Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{RMS}
Test Voltage	1kV _{RMS}
Nennspannung	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Voltage Rating	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.

Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins. Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.



Series	Contacts*	Rows*	Sleeve Plating	Clip Plating*	Packaging*
1532	010	1	50	00	PPST
	003-011 Einreihig Single row 004-072 Zweireihig Double row	1 Einreihig B1 Single row B1 2 Einreihig B2 Single row B2 3 Zweireihig Double row	50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	00 Feder vergoldet Gold plated clip 10 Feder 0,25µm Gold 0.25µm gold plated clip 30 Feder 0,75µm Gold 0.75µm gold plated clip	ST PPST PPTR

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad

PPST In Stangen mit P&P-Pad / In tubes with P&P-Pad

PPTR Tape & Reel / Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

